



NC520 SAC305



Soldadura en Pasta No Clean Libre de Plomo

Características:

- Para utilizar con los Demandantes Ensamblajes Electrónicos de Alta Densidad
- Fórmula Extremadamente Estable
- Reduce Voids en Pads QFN
- ROL0 per J-STD-004
- Hundimientos Reducidos
- Amplia Ventana de Proceso de Impresión
- Características de Impresión Mejoradas
- REACH Compliant

Descripción:

La NC520 está diseñada para los ensamblajes electrónicos de alta densidad más demandantes. La NC520 ha sido desarrollada para ofrecer excelente wetting, impresión mejorada y para reducir voids. La habilidad superior de wetting de la NC520 da como resultado uniones de soldadura brillantes, tersas y uniformes con aleaciones SAC. Un innovador sistema activador ofrece excelente wetting en una amplia gama de perfiles. El wetting mejorado reducirá los voids en planos QFN, LGA e interconexiones BGA. La eficiencia de transferencia consistente en la NC520 reduce hundimientos (HIP) aún cuando la coplanaridad del componente/substrato no sea óptima.

Impresión.

- Aplique suficiente pasta al estencil para permitir un movimiento suave y parejo durante el ciclo de impresión. Una gota con un diámetro de 15-20 mm (dedo índice) es suficiente.
- La aplicación de pequeñas cantidades de soldadura en pasta fresca al estencil a intervalos controlados mantendrá la química de la pasta mejor que un depósito mayor en un período de tiempo extendido.
- La NC520 está formulada para mantener una excelente eficiencia de transferencia después de pausas extendidas, sin embargo, será necesario trabajarla después de pausas mayores de 60 minutos, lo que mejorará su desempeño.
- La limpieza de su estencil variará por aplicación, sin embargo, si se requiere un solvente, utilice el limpiador de estencil de AIM DJAW-10 ya sea a mano, o si se prefiere, en limpiadores automatizados de estencil. El Alcohol Isopropil (IPA) NO se recomienda para la limpieza de estenciles durante el proceso de impresión.

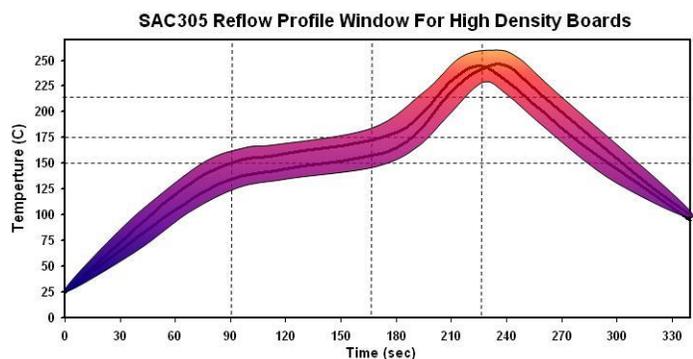
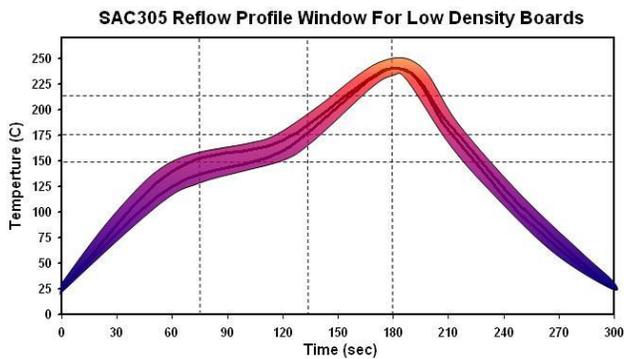
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA DE LA IMPRESORA, DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL PCB Y DE LA PISTA

PARÁMETRO	CONFIGURACIÓN INICIAL RECOMENDADA	PARÁMETRO	CONFIGURACIÓN INICIAL RECOMENDADA
Presión de la Boquilla	0.9 - 1.5 lbs/pulgada, de la navaja	Distancia de Separación del PCB	0.75 - 2.0 mm (.030-.080")
Velocidad de la Boquilla	0.5 - 6 inches/segundo	Velocidad de Separación del PCB	3.0 - 20.00 mm/segundo
Distancia de Desprendimiento	Al Contacto 0.00 mm (0.00")		

Perfil de Reflujo:

A continuación encontrará lineamientos generales para Rampa Remojo-Pico y Rampa-Pico. Las diferencias más importantes son el tiempo para alcanzar las temperaturas pico, y tiempo por sobre la licuefacción (TAL). El perfil más corto es adecuado para ensamblajes de masa térmica baja-media. El perfil más largo aplicaría a ensamblajes de masa alta, como tableros de alta densidad térmica y planos posteriores. El tiempo extendido y la temperatura de un perfil RSS son necesarios para minimizar el ΔT de un tablero de masa alta. El área sombreada define la ventana de proceso para la NC520. La eficiencia del horno, masa/densidad del tablero, tamaño del componente y Clase de Aceptación IPC todos influyen las configuraciones finales del perfil. Éstos perfiles son puntos de partida

generales y se recomiendan ampliamente coples térmicos anexos para optimizar el proceso. Para el procesamiento de la asistencia, por favor póngase en contacto con Soporte Técnico AIM visitando <http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts>.



<i>RAMPA DE PRE CALENTAMIENTO</i> 2° C/SEC MAX	<i>RAMPA A</i> 150° C (302° F)	<i>PROGRESO A TRAVÉS DE</i> 150° C-175° C (302° F-347° F)	<i>A TEMPERAT. PICO</i> 230° C- 245° C (445° F- 474° F)	<i>TIEMPO SOBRE</i> 217° C (425° F)	<i>ENFRIAMIENTO</i> ≤ 4 ° C / SEC	<i>PERFIL DE DISTANCIA DE TEMP.AMBIENTE AL PUNTO DE ENFRIAMIENTO</i>
Perfiles Cortos	≤ 60 Sec	15-45 Sec	45-75 Sec	45-60 Sec	45± 15 Sec	2.75-3.75 Min
Perfiles Largos	≤ 90 Sec	60-90 Sec	45-60 Sec	45-75 Sec	45± 15 Sec	4.0-5.0 Min

Limpeza:

- La NC520 no requiere limpieza; sin embargo puede limpiarse, de ser necesario, con agua con saponificador o con un limpiador solvente adecuado.
- Para los resultados de pruebas de limpiadores compatibles, sírvase contactar el Departamento de Soporte Técnico de AIM en <http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts>.

Manejo y Almacenaje:

- La NC520 es mejor si se utiliza dentro de los primeros 9 meses a 4° C-12° C (40° F-55° F).
- Permita que la soldadura en pasta se caliente completa y naturalmente a temperatura ambiente (8 hrs.) antes de romper el sello para utilizarla.
- Mezcle el producto ligera y completamente (1-2 minutos max).
- No almacene pasta nueva y usada en el mismo contenedor.
- Vuelva a sellar cualquier contenedor abierto, mientras no esté en uso.
- Vuelva a colocar las tapas interiores y exteriores del tarro de 500 gramos para minimizar la exposición de la pasta no utilizada a la atmósfera.
- Visite <http://www.aimsolder.com/services/applications-advice> para instrucciones detalladas del manejo de la pasta.

Propiedades Físicas:

<i>ITEM</i>	<i>ESPECIFICACIÓN</i>
Apariencia	Gris, Suave, Cremosa
Aleación	SAC305
Punto de Fusión	217° -218° C
Tamaño de las Partículas	T3, T4
Viscosidad	Per J-STD-005 IPC TM 650 2.4.34
Presentación	Disponible en todas las presentaciones estándares de la industria.

Resumen de Datos de Pruebas:

CLASSIFICATION			
Nombre del Producto	Clasificación IPC a J-STD-004B		
NC520	ROLO		
PRUEBA DEL POLVO			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Tamaño del Polvo	Tipo 3 (45-25 micrones) Tipo 4 (38-20 micrones)	IPC TM 650 2.2.14
2	Forma del Polvo	Esférico	Microscopio
PRUEBA MEDIA DE FLUX			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Valor Ácido	150 +/- 5 mg KOH/ g flux	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.13
2	Haluros Cuantitativos	Cromato de Plata - Pase	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.28.1
3	Haluros Cuantitativos, Lugar Fluoruro	Sin fluoruro	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.35.1
4	Prueba de Corrosión/Espejo de Cobre	Bajo	J-STD-004 IPC TM 650 2.3.32
5	Corrosión del Flux	Pasa	J-STD-004 IPC TM 650 2.6.15
6	Resistencia Aislante de la Superficie	Pasa – Ver el Reporte de Pruebas de AIM	J-STD-004 IPC TM 650 2.6.3.7
7	Bomba de Oxígeno	Bromina 613 mg/Kg Cloro <125 mg/Kg	EN 14582:2007 SW 9056 SW 5050
PRUEBA DE VISCOSIDAD			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Método de Prueba de Eje de la Barra T	500 - 900 kcps	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.34
PRUEBA DE SOLDADURA EN PASTA			
No.	Item	Resultados	Método de Prueba
1	Prueba de Punto	48.4 g	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.44
2	Prueba de Punto	94.8 g	JIS Z 3284 Anexo 9
3	Prueba de Bolas de Soldadura	Pasa	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.43
4	Prueba de Wetting	Pasa	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.45
5	Vida útil de la pasta	4°C (39°F) = 9 meses	AIM TM 125-11
6	Prueba de Slump de la Soldadura en Pasta	Pasa	J-STD-005 IPC TM 650 2.4.35

anada +1-514-494-2000 · USA +1-401-463-5605 · México +52-656-630-0032 · Europa +44-1737-222-258
 Asia-Pacífico +86-755-2993-6487 · India +91-80-41554753 · info@aimsolder.com · www.aimsolder.com
 AIM TIENE CERTIFICACIÓN ISO9001:2008 & ISO14001:2004

La información aquí contenida se basa en datos considerados como exactos y se ofrece sin cargo alguno. La información del producto se basa en la consideración de manejo y operación adecuados. Toda la información relacionada a la soldadura en pasta se produce con polvo de 45 micrones. Se excluye de toda responsabilidad por cualquier pérdida o lesión derivada del uso de esta información o de cualquier material designado. Para revisar los términos y condiciones de AIM refiérase a <http://www.aimsolder.com/Home/TermsConditions.aspx>